公司代码：688286　　公司简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 41,636,093.96 元，母公司期末累计可供分配利润为人民币 135,375,501.33 元。公司本年度利润分配的预案如下：

公司拟以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本 53,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.4 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 12,768,000.00 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.67%。2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	敏芯股份	688286	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	董铭座	仇伟
办公地址	苏州工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 501 室	苏州工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 501 室
电话	0512-62956055	0512-62956055
电子信箱	ir@memsensing.com	ir@memsensing.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司作为国内唯一掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司，致力于成为行业领先的 MEMS 芯片平台型企业。经过多年的技术积累和研发投入，公司在现有 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术，同时能够自主设计为 MEMS 传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC 芯片，并实现了 MEMS 传感器全生产环节的国产化。公司目前主要产品线包括 MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器。

MEMS 工艺本质上是一种微制造技术，基于 MEMS 技术制造的芯片有着低功耗、小型化和智能化的特征，是 MEMS 传感器和执行器的核心。MEMS 芯片作为连接真实世界和数字世界最前端的芯片，有着“比模拟芯片更模拟的芯片”之称。在 5G 乃至未来更快传输速度和更大承载量的数据网络支持下，万物互联具备了发展的基础，MEMS 传感器和执行器担负着数据世界中比同人的感官和神经末梢的功能，将迎来巨大的发展机遇。

公司将围绕传统消费电子（例如手机、电脑、耳机、手表等便携设备）、新兴消费电子（例如电子烟）、汽车、工业控制和医疗等下游市场，已经成即将开发和提供包括声学传感器、压力传感器、压感传感器、惯性传感器、流量传感器、微流控执行器、光学传感器等器件级产品，并针对下游市场需求，在丰富传感器产品类型的同时，还将提供包括惯导模组、车用各类压力模组、激光雷达模组等系统级产品。目前已使用公司产品的品牌包括华为、传音、小米、三星、OPPO、VIVO、联想、索尼、LG 等。

（二）主要经营模式

1、研发模式

MEMS 本质上是一种微制造技术，芯片结构设计与工艺实现之间密不可分，二者同时构成 MEMS 企业的核心竞争壁垒。

MEMS 行业就芯片的种类而言，具有较高的集中度，根据 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2020》，2019 年，惯性、射频、压力、声学、流量控制、光学、红外等七大类 MEMS 传感器在整个 MEMS 传感器市场总量的占比分别为 27.7%、19.2%、14.3%、10.6%、9.4%、5.4%、4.5%，合计占比超过 90%。根据这一特点，公司制定了成为“行业领先的 MEMS 芯片平台型企业”的发展目标，从芯片上游溯源，选择下游器件和模组市场容量或潜力较大的 MEMS 芯片种类进行研发，自芯片端确定研发方向，再根据下游应用场景的需要，有针对性的在封装和测试端进行后段研发。

2、采购模式

公司制定了《采购管理制度》，建立了相应的管理体系，以保证对供应商的有效管理。公司生产经营过程中所需的原材料、设备和办公用品等商品的采购均需统一由需求部门以《采购申请单》的形式提出申购需求，经相应权限人员审批后，运营部方可正式开展采购工作。公司根据《供应商评价考核管理制度》评估和遴选新供应商，并定期进行供应商评价考核，将评审合格的供应商纳入《合格供应商名册》。运营部门通过查阅《合格供应商名册》和采购记录，优先选择优质供应商进行询价，经过比价议价后，确定供应商采购订单，交运营总监和相应公司管理层审核确定后，再由运营部执行采购。

3、生产模式

公司产品的生产过程中，在封装和测试等生产环节，采用委外加工和子公司加工两种模式相结合的方式，公司也建立了委外加工的相关管理制度，以加强对委外加工供应商的管理。在生产加工过程中，运营部也密切关注委外加工厂商及子公司的动态，定期对加工厂商进行评价和考核。同时，对于存放在加工厂商处的原材料，公司也安排相关人员定期前往各工厂进行盘点，保证存放在加工厂商处原材料的有效管理。

4、销售模式

公司产品销售采用“经销为主，直销为辅”的销售模式。经销模式下，经销商根据终端客户需求向公司下订单，向公司采购产品后再销售给终端客户。直销模式下，客户直接向公司下订单采购所需产品。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为 MEMS 传感器产品的研发与销售。按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据中华人民共和国国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）中的“敏感元件及传感器制造”（C3983）。

1. 行业发展阶段

MEMS 技术于 1980 年代发明，是一种利用硅基半导体制造工艺制造微型机械电子系统的技术，最早在汽车和军工领域有部分应用，主要产品包括 MEMS 传感器和 MEMS 执行器。使用 MEMS 工艺制造的器件具有小型化、可智能化的特点，契合物联网中边缘端设备采集不同维度、海量数据过程中对低功耗、一致性高的需求。但在 4G 网络诞生以前，由于通信网络数据传输和承载能力有限，MEMS 传感器的市场需求亦非常有限，正如胎儿时期的人类由于神经网络尚未发育，相应的感官器官的发展也会受到限制。

纵观 MEMS 行业的发展历史，汽车产业、医疗及健康监护产业、通信产业以及手机和游戏机等个人电子消费品产业相继促进了 MEMS 产业的快速发展。尤其是 2007 年以来，随着以智能手机为代表的消费电子产品的快速普及和发展，MEMS 商业化的进展明显加快。从而伴随着 4G 网络和智能手机的诞生，MEMS 器件在过去十余年时间里有了非常显著的发展，根据 IHS 的报告，至 2019 年整个 MEMS 器件市场的容量为 165 亿美元，而中国信通院的报告显示，下游智能传感器市场的全球市场总量达到 378.5 亿美元。

但整个 MEMS 器件及下游的智能传感器市场仍然处于发展的初期，主要原因在于：一、随着 5G 网络及之后通信网络数据传输速度和承载能力的进一步提高，边缘端设备感知能力的市场需求才能进一步有效产生，而 MEMS 器件的低功耗、一致性高以及微小型化极大地契合了这一需求，更多新兴的 MEMS 器件需求以及现有 MEMS 器件的全新应用场景将在未来 10 年内持续产生；二、传感器是物联网的核心数据入口，物联网的发展带动智能终端设备普及，推动 MEMS 需求量增长。据全球移动通信系统协会 GSMA 统计和预测，2019 年全球物联网设备数量为 120 亿台，预计到 2025 年将增长至 246 亿台，2019 年到 2026 年将保持 12.7%的复合增长率；三、全球主要工业国家的人口出生率近年来均出现了不同程度的下降，用工成本和供需矛盾将进一步凸显，旨在减少用工人员的工业制造智能化的需求涌现，越来越多的制造业工厂正在经历智能化改造，而 MEMS 传感器在智能化制造过程中的应用属于刚需，需求将不断提升。

国内掌握核心技术的 MEMS 企业在未来 10 年将面临前所未有的发展机遇。首先，中国是消费电子、汽车、工业制造的主要集中地，这就意味着中国 MEMS 芯片企业可以与下游市场建立更为紧密的联系。而国外的 MEMS 芯片提供商多为美飞凌、意法半导体、德州仪器、ADI 等大型模拟芯片厂商以及博世、霍尼韦尔等脱胎于汽车和工业制造供应商的模组厂商，企业体系内原有利益格局较为稳定，相比国内专业的 MEMS 芯片企业，其在紧贴下游的服务意识和服务半径方面均存在一定劣势，对新市场新需求的响应也会相对落后，国内厂商相比而言更能把握住下游市场新的颠覆性需求；国外模拟类芯片大厂多采用 IDM 模式，并因此得以在行业发展初期占据优势地位，而国内 MEMS 芯片企业在发展初期普遍受限于资金，多采用 Fabless 的模式。因此这也是国内 MEMS 产品的产业化进程周期较长的一个关键原因，同时也是目前国际 MEMS 芯片厂商仍然处于领先地位的重要因素。而国内 MEMS 芯片领先企业在制造端的投入将缩短新产品的产业化进程，大大提高其在整个 MEMS 行业中的竞争力。

2. 基本特点

与大规模集成电路产品均采用标准的 CMOS 生产工艺不同，MEMS 传感器芯片本质上是在硅片上制造极微小化机械系统和集成电路的集合体，需要综合运用多学科、多行业的知识与技术、生产加工工艺具有明显的非标准化和高度的定制化以及对产品供应链体系的支撑有着非常高的要求等特点。MEMS 芯片具有非常强的工艺特征，三维制造工艺与集成电路的二维制造工艺相差甚大，这也是国家十四五规划中明确将 MEMS 特殊工艺的突破纳入其中的重要原因。

③主要技术门槛

（1）跨行业知识与技术的综合运用

MEMS 是一门交叉学科，MEMS 产品的研发与设计需要机械、电子、材料、半导体等跨学科知识以及机械制造、半导体制造等跨行业技术的积累和整合。MEMS 行业的研发设计人员需要具备上述专业知识技术的深入储备和对上下游行业的深入理解，才能设计出既满足客户需求，又适合供应商实际加工能力的 MEMS 产品，因此对研发人员的专业知识和行业经验都提出了较高的要求。

（2）各生产环节均存在技术壁垒

与大规模集成电路行业相比，MEMS 产品的研发步骤更加复杂，除了完成 MEMS 传感器芯片的设计外，还需要开发出适合公司芯片设计路线的 MEMS 晶圆制造工艺。在晶圆制造厂商缺乏成熟的 MEMS 工艺模块的情况下，公司需要参与开发适合晶圆制造厂商的制造工艺模块，即使在晶圆制造厂商已经具备成熟制造工艺模块的情况下，公司也需要根据公司的芯片设计路线确定每款芯片的具体工艺流程。由于 MEMS 传感器需要与外界环境进行接触，感知外部信号的变化，所以需要对成品的封装结构和封装工艺进行研发与设计，以降低产品失效的可能性。由于 MEMS 传感器承担了对外部信号的获取和转换等功能，下游应用场景多样，产品内部的极微小型机械系统对外界应用环境相对敏感，因此公司还需要负责 MEMS 专业测试设备系统和测试技术的开发，以满足 MEMS 传感器产品性能和质量测试的需求。因此，MEMS 传感器行业在芯片设计、晶圆制造、封装和测试环节都具有壁垒。

（3）技术工艺非标准化

MEMS 传感器具有一种产品一种加工工艺的特点。MEMS 传感器产品种类多样，各种产品的功能和应用领域也不尽相同，使得各种 MEMS 传感器的生产工艺和封装工艺均需要根据产品设计进行调试，晶圆和成品的测试过程也采取非标准工艺，因此 MEMS 传感器产品不存在通用化的技术工艺，需要从基础研发开始对产品设计、生产工艺、设备开发和材料选取等各生产要素经历长时间的研发和投入，并在大量出货的过程中不断对上述生产要素进行完善和优化。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）市场排名与客户资源

公司自主研发的 MEMS 传感器产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能家居、可穿戴设备等消费电子产品，同时也逐渐在汽车和医疗等领域扩大应用，目前已使用公司产品的品牌包括华为、传音、小米、三星、OPPO、VIVO、联想、索尼、LG 等、九安医疗、乐心医疗等。

公司生产的 MEMS 声学传感器出货量位列世界前列；根据 IHS Markit 的数据统计，2016 年公司 MEMS 声学传感器出货量全球排名第六，2017 年公司 MEMS 声学传感器出货量全球排名第五，2018 年公司 MEMS 声学传感器出货量全球排名第四。根据 Omdia 的数据统计，2019 年 MEMS 声学传感器中 MEMS 芯片的出货量，全球排名第三。

（2）技术实力与科研成果

公司专注于 MEMS 传感器的自主研发与设计，经过多年的研发投入，公司完成了 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各生产环节的基础研究工作和核心技术积累，并帮助国内厂商开发了 MEMS 制造工艺，搭建起本土化的 MEMS 生产体系。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有境内外发明专利 38 项、实用新型专利 57 项，正在申请的境内外发明专利 113 项、实用新型专利 129 项。公司依靠核心技术自主研发与生产的 MEMS 声学传感器产品在产品尺寸、灵敏度、灵敏度公差等多项指标上处于行业先进水平，并在业内率先推出采用核心技术生产的最小尺寸商业化三轴加速度计。

公司积极参与并完成了如下国家级或省级科研项目：2014 年协同参与完成国家 863 计划“CMOS-MEMS 集成麦克风”项目；2015 年完成江苏省省级科技创新与成果转化专项“新型 MEMS 数字声学传感器的研发及产业化”；2017 年完成江苏省省级工业和信息产业转型升级专项“低功耗 IIS 数字输出 MEMS 声学传感器的研发及产业化”；2020 年省科技成果转化专项资金－惯性传感器的研发及产业化。

公司先后获得“2013 年度十大中国 MEMS 设计公司品牌”、2016 和 2017 年大中华 IC 设计成就奖、中国半导体行业协会 2018 和 2019 年“中国半导体 MEMS 十强企业”、入选“中国 IC 设计 100 家排行榜之传感器公司十强”。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

MEMS 传感器目前已经广泛运用于消费电子、汽车、工业、医疗、通信等各个领域，随着人工智能和物联网技术的发展，MEMS 传感器的应用场景将更加多元。MEMS 传感器是人工智能重要的底层硬件之一，传感器收集的数据越丰富和精准，人工智能的功能才会越完善。物联网生态系统的核心是传感、连接和计算，随着联网节点的不断增长，对智能传感器数量和智能化程度的要求也不断提升。未来，智能家居、工业互联网、车联网、智能城市等新产业领域都将为 MEMS 传感器行业带来更广阔的市场空间。因其得天独厚的优势，MEMS 传感器应用绝不仅局限于可穿戴设备，未来医疗、人工智能以及汽车电子等领域的传输底层架构均要依赖 MEMS 传感器来布局。　从目前全球的发展趋势来看，汽车工业和消费类电子的市场已经发展的足够发达，成为了 MEMS 传感器的发展基础。未来，医疗、人工智能、物联网、智慧城市等应用领域智能现代化趋势明显，MEMS 传感器的发展潜力很大。

未来的技术发展趋势：

（1）MEMS 和传感器呈现多项功能高度集成化和组合化的趋势。由于设计空间、成本和功耗预算日益紧缩，在同一衬底上集成多种敏感元器件、制成能够检测多个参量的多功能组合 MEMS 传感器成为重要解决方案。

（2）传感器智能化及边缘计算。软件正成为 MEMS 传感器的重要组成部分，随着多种传感器进一步集成，越来越多的数据需要处理，软件使得多种数据融合成为可能。MEMS 产品发展必将从系统应用的定义开始，开发具有软件融合功能的智能传感器，促进人工智能在传感器领域更广阔的应用。

（3）传感器低功耗及自供能需求日趋增加。随着物联网等应用对传感需求的快速增长，传感器使用数量急剧增加，能耗也将随之翻倍。降低传感器功耗，采用环境能量收集实现自供能，增强续航能力的需求将会伴随传感器发展的始终，且日趋强烈。

（4）MEMS 向 NEMS 演进。随着终端设备小型化、种类多样化，推动微电子加工技术特别是纳米加工技术的快速发展，智能传感器向更小尺寸演进是大势所趋。与 MEMS 类似，NEMS（纳机电系统）是专注纳米尺度领域的微纳系统技术，只不过尺寸更小。

（5）新敏感材料的兴起。薄膜型压电材料具有更好的工艺一致性、更高的可靠性、更高的良率、更小的面积，可用于 MEMS 执行器、扬声器、触觉和触摸界面等。未来 MEMS 器件的驱动模式预计将从传统的静电梳齿驱动转向压电驱动。

（6）更大的晶圆尺寸。相比于目前业界普遍　应用的 6 英寸、8 英寸晶圆制造工艺，更大的晶圆尺寸能够很大程度上降低成本、提高产量，并且晶圆尺寸的扩大与芯片特征尺寸的缩小是相应促进和互相推动的。例如，用 12 英寸晶圆工艺线制造的 MEMS 产品已经出现。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,123,763,708.05	339,485,437.58	231.02	167,768,200.31
营业收入	330,074,706.48	284,030,867.58	16.21	252,713,394.00
归属于上市公司股东的净利润	41,636,093.96	59,482,934.97	-30.00	53,251,306.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,625,733.76	50,936,330.58	-30.06	61,383,745.21
归属于上市公司股东的净资产	1,062,135,619.94	285,160,993.58	272.47	136,129,094.87
经营活动产生的现金流量净额	18,405,916.32	42,557,181.82	-56.75	47,307,463.40
基本每股收益（元/股）	0.94	1.53	-38.56	1.48
稀释每股收益（元/股）	0.94	1.53	-38.56	1.48
加权平均净资产收益率(%)	7.55	27.68	减少 20.13 个百分点	52.18
研发投入占营业收入的比例(%)	12.74	12.56	增加 0.18 个百分点	10.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	57,895,000.04	75,218,997.53	102,178,807.47	94,781,901.44
归属于上市公司股东的净利润	6,236,818.39	10,806,568.89	13,992,961.28	10,599,745.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,523,986.29	10,392,541.48	14,116,597.27	5,592,608.72
经营活动产生的现金流量净额	-12,930,374.30	4,016,893.42	2,197,319.56	25,122,077.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,521
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,446
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

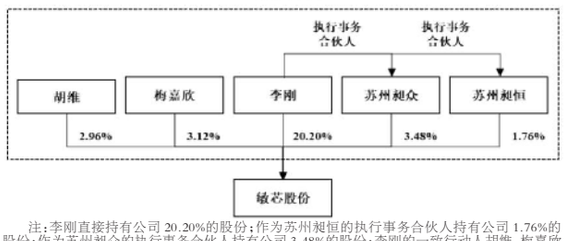
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
李刚	0	10,745,026	20.20	10,745,026	0	无	0	境内自然人
中新苏州工业园区创业投资有限公司	0	4,831,023	9.08	4,831,023	0	无	0	国有法人
上海华芯创业投资企业	0	4,820,349	9.06	4,820,349	0	无	0	其他
苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）	0	1,850,000	3.48	1,850,000	0	无	0	境内非国有法人
西藏凯风进取创业投资有限公司	0	1,682,886	3.16	1,682,886	0	无	0	境内非国有法人
梅嘉欣	0	1,658,930	3.12	1,658,930	0	无	0	境内自然人
胡维	0	1,573,456	2.96	1,573,456	0	无	0	境内自然人
南京中益仁投资有限公司-日照市益敏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,531,563	2.88	1,531,563	0	无	0	境内非国有法人
腾晋	1,451,893	1,451,893	2.73	0	0	无	0	境内自然人
苏州工业园区创业投资引导基金管理中心	0	1,242,309	2.34	1,242,309	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李刚、胡维、梅嘉欣通过签署《一致行动协议》构成一致行动人；李刚系苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）普通合伙人，二者构成一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

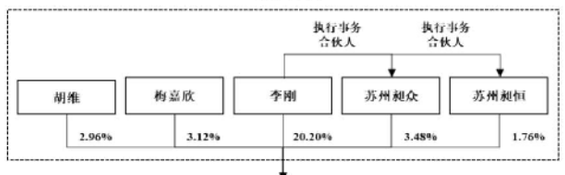
√适用　□不适用



注：李刚直接持有公司 20.20%的股份；作为苏州昶恒的执行事务合伙人持有公司 1.76%的股份；作为苏州昶众的执行事务合伙人持有公司 3.48%的股份；李刚的一致行动人胡维、梅嘉欣分别直接持有公司 2.96%、3.12%的股份，李刚及其一致行动人合计持有公司 31.52%的股份。基于上述，李刚系公司的控股股东和实际控制人。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



注：李刚直接持有公司 20.20%的股份；作为苏州昶恒的执行事务合伙人持有公司 1.76%的股份；作为苏州昶众的执行事务合伙人持有公司 3.48%的股份；李刚的一致行动人胡维、梅嘉欣分别直接持有公司 2.96%、3.12%的股份，李刚及其一致行动人合计持有公司 31.52%的股份。基于上述，李刚系公司的控股股东和实际控制人。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 33,007.47 万元，同比增长 16.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,163.61 万元，同比下降 30.00%；报告期末总资产 112,376.37 万元，较期初增长 231.02%；归属于母公司的所有者权益 106,213.56 万元，较期初增长 272.47%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司共计四家，具体请阅“本节、八之合并范围的变更”和“本节、九之在其他主体中的权益”。

证券代码：688286　　证券简称：敏芯股份　　公告编号：2021-021

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：人民币 5,000 万元

4、保费支出：不超过 55 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可执行。

二、监事会意见

监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查，我们认为公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们同意公司为董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交至公司 2020 年年度股东大会进行审议。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码：688286　　证券简称：敏芯股份　　公告编号：2021-014

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1364 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,330 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共计募集资金 83,351.10 万元，坐扣承销和保荐费用 7,302.77 万元后的募集资金为 76,048.33 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,816.24 万元后，公司本次募集资金净额为 73,232.09 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕298 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	73,232.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额及理财产品收益	B2	
本期发生额	项目投入	C1	27,358.39
	利息收入净额及理财产品收益	C2	474.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,358.39
	利息收入净额及理财产品收益	D2=B2+C2	474.32
应结余募集资金		E=A-D1+D2	46,348.03
实际结余募集资金		F	46,455.97[注 1]
差异		G=E-F	-107.94[注 2]

[注 1]：实际结余募集资金分别为募集资金银行账户期末余额 27,455.97 万元和购买理财产品期末余额 19,000.00 万元；

[注 2]：差异系尚未支付的发行费用，分别为证券日报费用 89.62 万元，相关印花税 18.32 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 8 月 4 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 9 月 24 日，公司及全资子公司昆山灵科传感技术有限公司（以下简称“昆山灵科”）、苏州德斯倍电子有限公司（以下简称“德斯倍”）分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行以及国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
公司	中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	10551301040054442	21,340,058.12	募集资金专户
公司	招商银行苏州中新支行	512903602710907	70,709,467.50	募集资金专户
公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001348411	127,851.95	募集资金专户
公司	中国民生银行姑苏支行	632235885	1,244,185.61	募集资金专户
公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801600004643	8,185,806.34	募集资金专户
德斯倍	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512908786510803	106,148,899.80	募集资金专户
德斯倍	中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	10551301040054723	309,672.37	募集资金专户
昆山灵科	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001362827	8,593,722.75	募集资金专户
公司	中国民生银行姑苏支行	708347596	17,900,000.00	通知存款账户
昆山灵科	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001418782	40,000,000.00	定期存款账户
合 计			274,559,664.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 10 月 23 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 106,629,151.43 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 6,239,166.82 元置换已从自有资金账户支付的发行费用（不含增值税）。

（1）本期置换先期投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	置换先期投入金额
MEMS 麦克风生产基地新建项目	40,026.09	6,244.76	6,244.76
MEMS 压力传感器生产项目	5,991.42	455.29	455.29
MEMS 传感器技术研发中心建设项目	14,655.00	3,962.87	3,962.87
补充流动资金项目	10,000.00		
合 计	70,672.51	10,662.92	10,662.92

（2）本期置换先期支付发行费用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金实际投入金额	置换先期投入金额
发行费用（不含增值税）	623.92	623.92
合 计	623.92	623.92

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资